

安全评价报告信息公开表格（浙江芯科半导体有限公司）

被评价单位名称		浙江芯科半导体有限公司	
评价项目名称/项目编号		浙江芯科半导体有限公司建设2英寸碳化硅MOSFET功率芯片生产线项目安全预评价/第2304013号	
项目简介（含图片）		<p>项目涉及的建构筑物：1#生产厂房、2#生产厂房、2#生产厂房（裙房）、H2房、化学品库、传达室等。</p> <p>建设规模与建设内容：项目为计算机、通信和其他电子设备研发制造外延制备实验室和工艺共性平台，用于研发及生产2英寸碳化硅MOSFET功率芯片产品，生产规模100000片每年。新增研发、测试及制造厂房等地上建筑面积65715.57m²，新增地下建筑面积3628.8m²。。</p>	
			
			
		 	
安全评价机构名称		浙江道宇安环保科技有限公司	
项目组长		夏字科	
技术负责人		蒋永成	
过程控制负责人		吴芳萍	
评价报告编制人		夏字科、汪胜红	
报告审核人		夏字科	
参与评价工作	安全评价师	夏字科、汪胜红、董继军、段建勇、袁福江	
	注册安全工程师	夏字科、汪胜红、董继军、段建勇、袁福江	
	技术专家	相继园、包晓跃、张永良	
现场开展安全评价工作	人员	夏字科、汪胜红	
	时间	2024.3.15—2024.5.6	
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告	
评价报告提交时间		2024.5.6	